

免清洗锡膏 TQ01-SBA351

华庆 TQ01-SBA351 无铅低温免清洗锡膏，由低氧化度锡粉与高效助焊剂在真空环境下混合而成。锡膏在常温下性质稳定，回流时能迅速释放活性，焊料熔化后流动性好、润湿性强。此款锡膏可广泛应用于散热模组、LED、高频头及其它需要中低温焊接的产品。

TQ01-SBA351 不含任何卤素。虽然在配方中排除了卤素，但突破性的配方设计，使其仍然具有卓越的焊接性能，对 OSP 铜、HASL 镀锡、镀银或镍焊盘等均有出色的润湿性，回流后焊点光亮饱满、无发黑。TQ01-SBA351 残留物无色透明、无腐蚀，具有业界最高的安全性能。

TQ01-SBA351 的回流窗口宽，能适应多种回流曲线，不同吸热部位的焊点均能获得良好、一致的焊接效果。

性能特点

- ☆ 完全不含卤素，真正的无卤锡膏
- ☆ 润湿性优良，适用于镍、钯等难焊金属
- ☆ 粘度稳定性，良好的涂布性能
- ☆ 焊点饱满光亮、无发黑、无锡珠
- ☆ 低空洞，达到 IPC7095 III 级空洞性能(最高级别)
- ☆ 焊接后焊点可靠性高，松香残留少，无色透明、无腐蚀性
- ☆ 可以在空气和氮气的环境下进行回流作业
- ☆ 适用的回流焊方式：红外线、气象式、对流式、传导式、热风式、雷射式。

基本特性

项目	数值	测试方法
合金成分	Sn64/Bi35/Ag1	JSTD-006
熔点	固相: 138°C/液相: 179°C	
金属含量	88.5%	IPC-TM-650 2.2.20
粘度	140-180 Pa.s	IPC-TM-650 2.4.34
热坍塌性	≥0.4mm	IPC-TM-650 2.4.35
卤素含量	0	EN 14582:2007
锡球	极少	IPC-TM-650 2.4.43
扩展率	≥78%	IPC-TM-650 2.4.46
钢网寿命	>8 小时	@25°C, RH:50%
残留物粘性测试	合格	JIS Z 3284 附件 12

安全性能

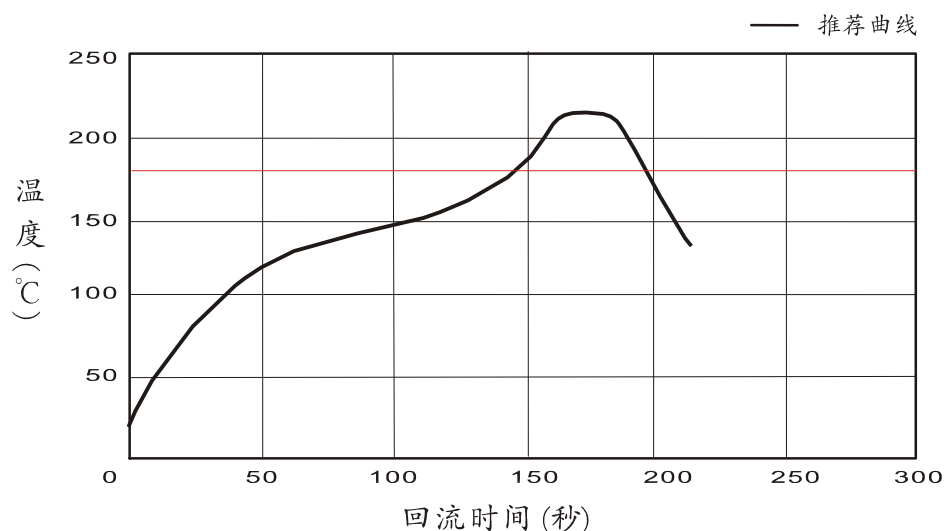
项目	数值	测试方法
铜板腐蚀	合格 (无腐蚀)	IPC-TM-650 2.6.15
铜镜试验	合格 (无穿透)	IPC-TM-650 2.3.32
铬酸银测试	合格 (无变色)	IPC-TM-650 2.3.33
氟化物测试	合格 (无变色)	IPC-TM-650 2.3.35.1
表面绝缘电阻	合格 ($>10^8$ ohms)	IPC-TM-650 2.6.3.3
	合格 ($>10^{11}$ ohms)	Bellcore GR78-CORE

推荐回流参数

1. 预热区：以每秒 1-2°C 的升温速率将温度从室温匀速上升至 130°C。最大升温 2.5°C/s
2. 保温区：用 60 秒-120 秒将温度平缓升至 160-180°C，使 PCB 表面受热均匀。
最大升温 2.5°C/S
3. 回流区：1) 根据不同产品,将峰值温度控制在 205-230°C 间。
2) 高于 180°C 的时间应控制在 30-90 秒间。
4. 冷却区：推荐降温速率 $\geq 2^\circ\text{C}/\text{秒}$ 。过慢的冷却速度有时易造成器件移位及降低焊接强度。

注意事项：避免在焊点完全凝固前移动产品！

推荐回流曲线



其它信息

包装：500g/罐 10 公斤/箱 储存：2-10°C

声明：用户应根据各自的使用目的自行负责判断本资料信息的适宜性。虽然在编写此资料时已足够谨慎，但此资料的准确性和适宜性不对用户的使用或使用结果负责或提供保证。